



Les fours de refusion par phase vapeur de la gamme SLC/BLC (disponibles en batch ou en ligne) sont parfaitement adaptés aux moyennes et grandes séries de production.

Ces fours permettent d'excellentes performances de brasage avec un faible encombrement au sol. Les nombreuses fonctionnalités brevetées offrent une grande flexibilité dans les process.

### Généralités

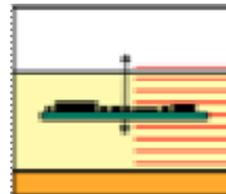
- 11 versions pour différentes tailles de cartes
- Faible encombrement au sol
- Conception double chambre
- Brasage sans oxygène ni apport de gaz N<sub>2</sub>
- Pas de surchauffe des composants
- Faible consommation électrique

### Equipment Standard / Spécifications

- Facilité de pilotage avec écran tactile
- Chargement entrée / sortie automatisé
- Mémorisation jusqu'à 50 programmes
- Large gamme de profils de brasage ajustables
- Faible consommation de fluide caloporteur avec conception 2-chambres et système de récupération de fluide
- Système ventilé de refroidissement intégré
- Maintenance et usure minimales (tous éléments mobiles hors zone vapeur)
- 4 canaux internes pour une mesure de température et un profilage optimisés
- Système de gestion d'énergie
- Niveau de fluide contrôlé
- Filtrage automatique du fluide

### Caractéristiques techniques

- IPS, Système Intelligent de Profilage, pour :
  - Profils régulés en température (SVTC : Soft Vapor Temperature Control),
  - Mode piloté, paramétrage et profilage en une seule étape
- Brasage plomb et sans plomb avec un seul fluide pour différentes températures maximum (pic de refusion)
- Logiciel de profilage intégré
- Mode Syncro (panier chaud/panier froid)
- Système transport sans maintenance (**breveté**)
- Facilité d'accès à la chambre vapeur



La facilité de programmation des différentes positions dans la vapeur permettent un ajustement optimal du gradient (pente) de température.

### Options

- Système Refroidissement Rapide (RCS) (breveté)
- Système élément chauffant IR (breveté)
- Logiciel VP-Control pour paramétrage, enregistrement et analyse de données process
- Ensemble PC complet intégré
- Barcode pour changement automatique de programme, traçabilité et stockage illimité
- Voies supplémentaires de mesure de température process
- Mode multi-niveaux pour changement aisé des différentes hauteurs de brasage
- Système anti-brouillard (AFS) pour une vision claire du process de refusion (breveté)
- Adaptateur pour refusion de cartes PCB double face
- Module de puissance secouru (onduleur)
- Chargement en ligne
- Groupe froid autonome



Données techniques	SLC309	SLC509/509i	SLC609/609i	SLC809/809i	BLC509/509i	BLC609/609i	BLC809/809i
Longueur (hors tout – mm)	940	1190 / 1720	1290 / 2020	1490 / 2220	1190 / 1720	1290 / 2020	1490 / 2220
Profondeur (mm)	1760	batch 1760mm / en ligne 2290mm		batch 1960mm / en ligne 2490mm			
Hauteur (mm)	1320 mm	batch 1320 mm / en ligne 1470 mm					
Poids (kg)	415 kg	500 / 730	550 / 830	600 / 1010	560 / 790	650 / 920	700 / 1070
h. chargement / déchargement	950 mm						
Taille max. cartes en <b>batch</b> (mm)	300 x 350 x 80	550 x 350 x 80	650 x 350 x 80	850 x 350 x 80	550 x 540 x 80	650 x 540 x 80	850 x 540 x 80
Taille max. cartes en <b>ligne</b> (mm)	N/A	530 x 309 x 65	630 x 309 x 65	630 x 309 x 65	530 x 400 x 65	630 x 400 x 65	630 x 400 x 65
Remplissage fluide	10 kg	15 kg	15 kg	20 kg	20 kg	20 kg	25kg
Raccordement eau	½" / 2,5 - 5 bar						
Débit d'eau	1,5l/min	2,5l/min	3l/min	3,5l/min	3l/min	3l/min	3,5l/min
Puissance max. de chauffe	3,9 kW	5,2 kW	6,5 kW	7,8 kW	7,8 kW	7,8 kW	9,1 kW
Puissance consommée	1,6 kW/h	2,1 kW/h	2,6 kW/h	3,1 kW/h	3,1 kW/h	3,2 kW/h	3,6 kW/h
Alimentation électrique	400 / 230 VAC, 50 Hz						
Fusible principal	20A "gL" ou "C"			25A "gL" ou "C"			32A "gL" ou "C"

- Sous réserve de modifications techniques